

性能特点：

- 频带：2~4GHz
- 插入损耗：0.7dB
- 隔离度：25dB
- 输入/输出电压驻波比：1.3/1.2
- 芯片尺寸：1.2mm×0.9mm×0.1mm

产品简介：

HH-PD0204VA 是一款 GaAs MMIC0°两路功分器芯片，该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、易集成等特点，广泛应用于功率分配及合成。其频率范围覆盖 2~4GHz，带内插入损耗 0.7dB。

电参数： (T_A=25°C)

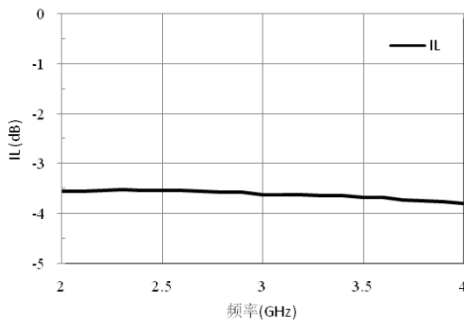
| 指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 频率范围 | 2~4 | | | GHz |
| 插入损耗 | - | 0.7 | - | dB |
| 隔离度 | - | 25 | - | dB |
| 输入电压驻波比 | - | 1.3 | - | - |
| 输出电压驻波比 | - | 1.2 | - | - |

使用限制参数：

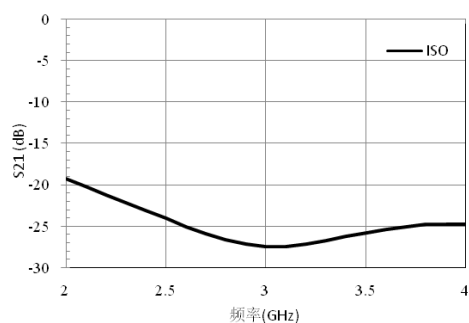
| | |
|------|-------------|
| 输入功率 | +27dBm |
| 存储温度 | -65°C~150°C |
| 使用温度 | -55°C~85°C |

典型曲线：

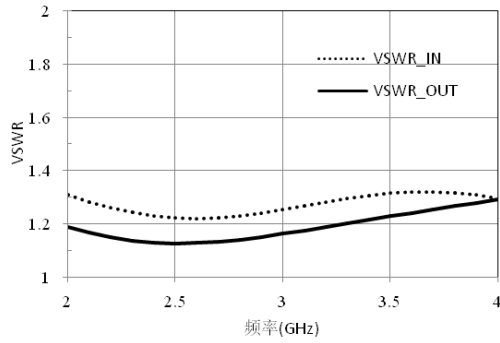
插入损耗



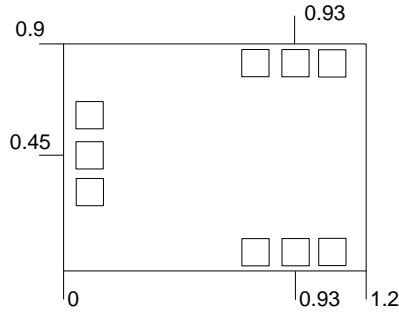
隔离度



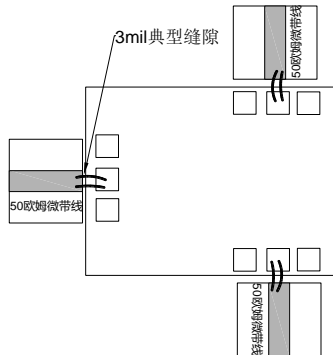
输入/输出电压驻波比



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。